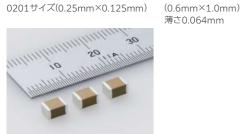
営業概況 At a Glance

コンデンサ

• 積層セラミックコンデンサ

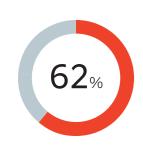


超小型積層セラミックコンデンサ 0201サイズ(0.25mm×0.125mm)



小型大容量積層セラミックコンデンサ 4532サイズ(4.5mm×3.2mm) 1.000µF

売上構成比 (2020年3月期)



1,706 **1,764** 1,428

2019

売上高の推移

(単位:億円)

薄さ0.064mm

小型、薄型、大容量、高信頼性の積層セラミックコンデン サの開発に注力しています。誘電体の材料技術、薄層・大 容量化技術および超小型品生産技術等を高度化すること により、最先端の積層セラミックコンデンサを開発し続け ています。

2020年3月期の業績は、情報機器向け、通信機器向け、 自動車向け、情報インフラ・産業機器向けの売上が前期と 比べ増加したことにより、売上高は3.4%増の1,764億57 百万円となりました。

フェライト及び応用製品

- 巻線インダクタ
- 積層チップインダクタなどの各種インダクタ商品



高周波積層High-Qチップ

メタル系パワーインダクタ 「MCOILTM (エムコイル)」

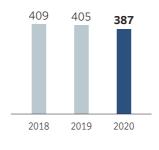


超小型積層チップインダクタ

売上構成比 (2020年3月期)





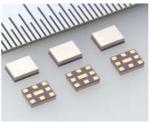


小型、薄型、大電流対応のインダクタに加え、自動車・情 報インフラをターゲットとした大型、高信頼性のインダク タの開発に取り組んでいます。材料開発、巻線・積層プロ セス技術を高度化させることで、競争力ある商品を開発し ています。

2020年3月期の業績は、民生機器向け、情報機器向け、 通信機器向け、情報インフラ・産業機器向けなどの売上が 前期比で減少したことにより、売上高は4.5%減の387億 70百万円となりました。

複合デバイス

- モバイル通信用デバイス(FBAR/SAW)
- ■電源モジュール
- 高周波モジュール
- 部品内蔵配線板「EOMIN™ (イオミン)」



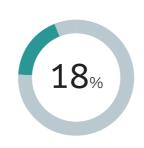


モバイル通信用デバイス 無線デバイス (FBAR/SAW)

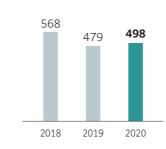


積層セラミックフィルタ

売上構成比 (2020年3月期)



売上高の推移 (単位:億円)



モバイル通信用デバイス(FBAR/SAW)の技術を高めた 新商品の開発、5G(第5世代移動通信システム)に向けた 次世代商品の開発、注力市場に向けて太陽誘電のコア技術 を融合したソリューション型商品の開発に注力しています。 2020年3月期の業績は、モバイル通信用デバイス

(FBAR/SAW)などの売上が前期比で増加したことにより、 売上高は3.9%増の498億8百万円となりました。

その他

- アルミニウム電解コンデンサ
- ■蓄電デバイス





アルミニウム電解コンデンサ

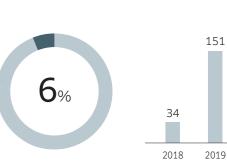
リチウムイオンキャパシタ

売上高の推移

172

(単位:億円)

売上構成比 (2020年3月期)



注力市場へ向けて蓄電デバイスの商品開発に注力して います。

2020年3月期の業績は、子会社のエルナー株式会社(前 期の第2四半期より計上)のアルミニウム電解コンデンサ などが加わり、前期比13.8%増の172億92百万円となり ました。

34 TAIYO YUDEN Report 2020 TAIYO YUDEN Report 2020 35